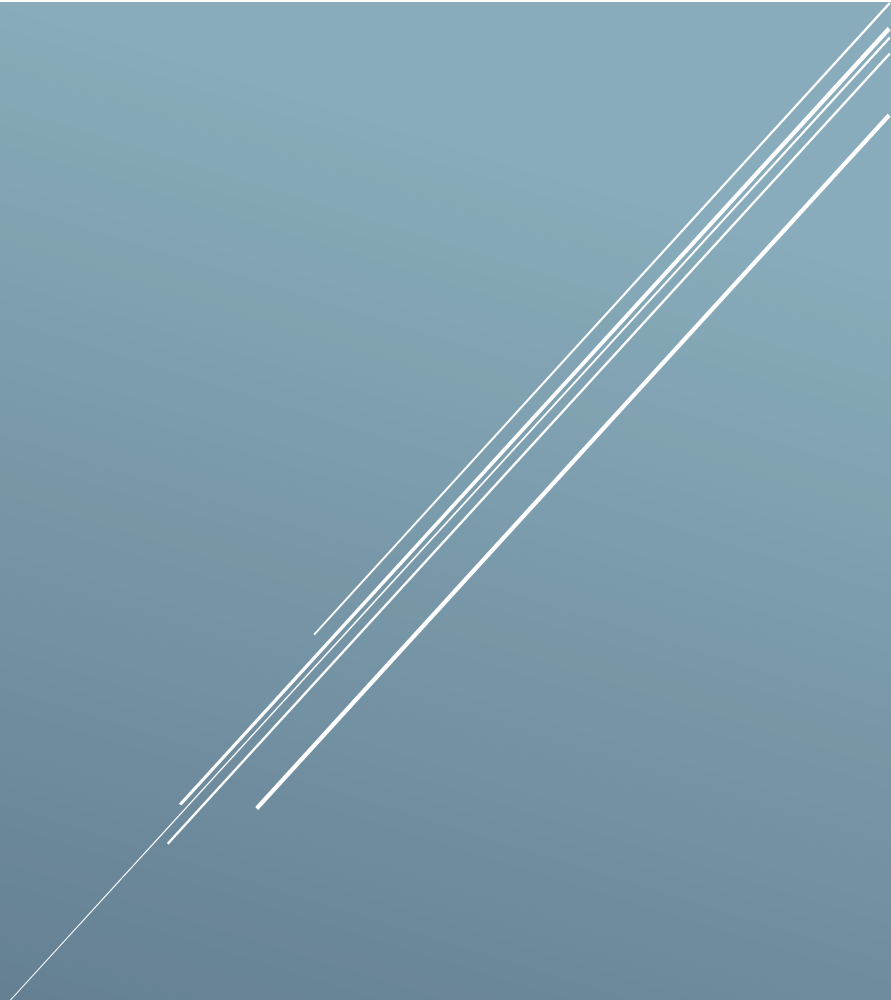




GUÍA BAJAR TEMPERATURA CHUWI VI10

Contenido

Guía para bajar temperatura chuwi vi10	2
Introducción	2
Lista de materiales	2
Procedimiento	3
Comprobación de temperaturas	12
Conclusión	13

Guía para bajar temperatura chuwi vi10

Introducción

El siguiente documento como su nombre indica consiste en una guía con una serie de pasos bien explicados para poder realizar una bajada de temperatura a vuestro procesador, con ello se consigue mejor rendimiento, alargar la vida de los materiales de la Tablet y cuestión también de que al tocar la Tablet esta no irradie tanto calor, haciendo que cogerla sea incómodo. La Tablet rondaba los 42° - 44° en reposo, con la mejora se sitúa en 28° - 31° también en reposo. Se descende unos 10° que son notorios en la carcasa trasera cuando se sostiene en las manos.

- *Antes de seguir hay que dejar claro que la guía es compartida con los demás por si le sirve o puede ayudar a alguien, así que evidentemente no me responsabilizo de los problemas que puedan surgirle a quien realice la guía. Siguiendo todo las partes y siendo meticuloso no debe haber problema alguno. Os animo a realizarla.*

Lista de materiales

Pasta térmica	1 tubo de 1 gramo es más que suficiente.
Chapa de cobre	20x20x0,5 mm
Almohadilla térmica silicona	Espesor 0.5 mm.
Materiales de despiece	Destornillador, palanca plástico
Papel para limpiar, algodón, alcohol	
Tijeras, cúter o cualquier cosa que corte	

Estos componentes son fácilmente encontrados en internet y no son caros.

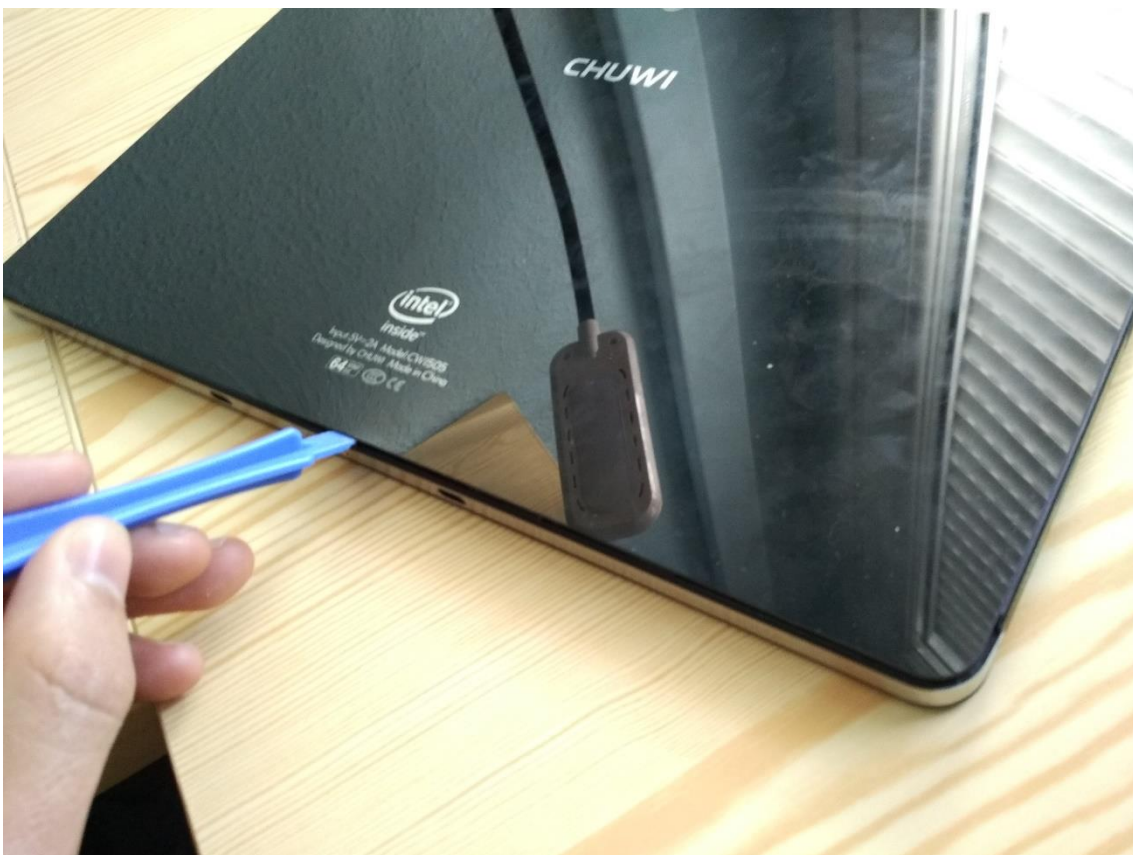
En la figura 1 aparecen las chapas de cobre y la almohadilla térmica por si surgen dudas.



Ilustración 1

Procedimiento

1. Bueno el primer paso es proceder a abrir la Tablet para acceder al contenido interior. Para ello debemos fijarnos en los extremos de la Tablet en el recubrimiento plateado tenemos 4 tornillos, uno en cada borde. Hay que quitarlos y ponerlos en un lugar seguro. En la imagen 2 se aprecian los tornillos a los que me refiero. Una vez quitados con la ayuda de una palanca de plástico se introduce entre Tablet y carcasa e irán saltando los clics. Así por todos los bordes (hay que tener cuidado).



Seguidamente lo que nos encontramos en gran parte una enorme batería a la derecha de la imagen 2, y la placa base con una pegatina negra, nos centraremos en esta parte y debemos quitar la pegatina esa negra dejando ver una chapa metálica como se muestra en la figura 3.



Ilustración 2

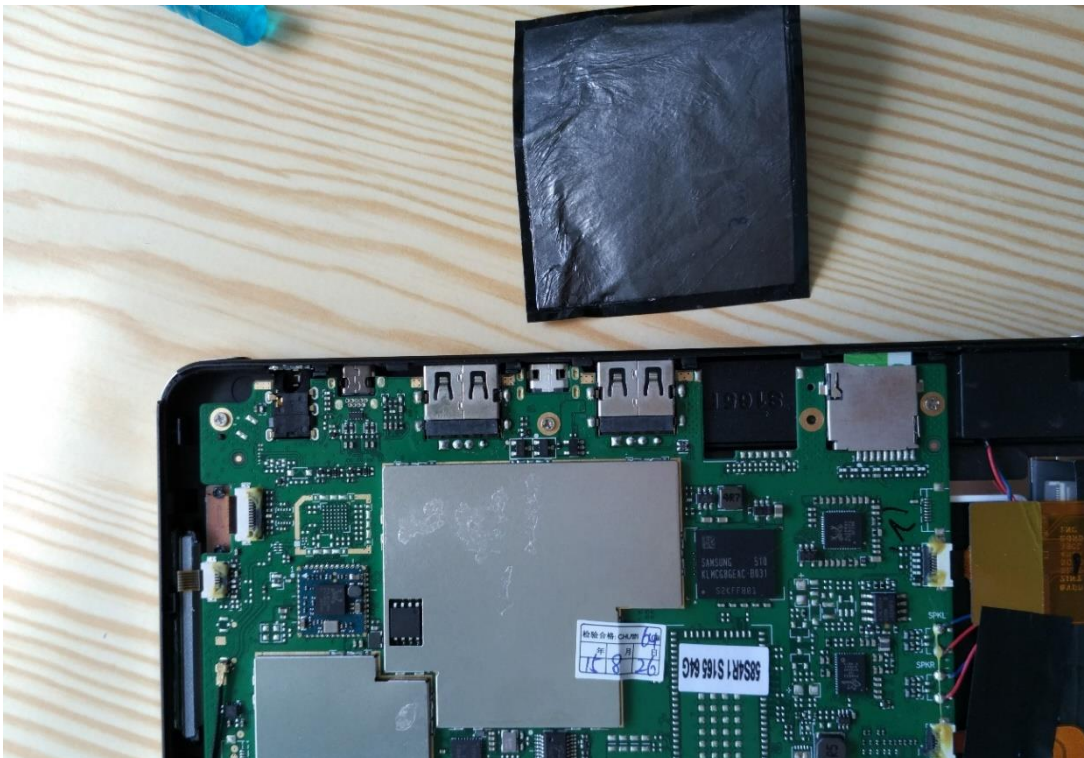
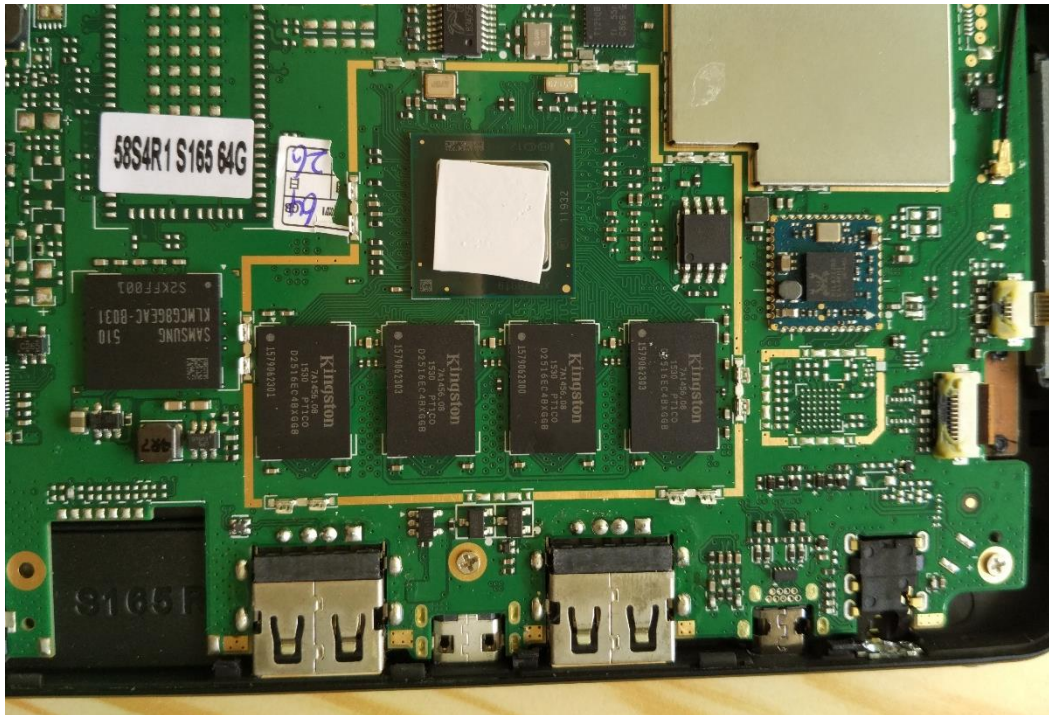
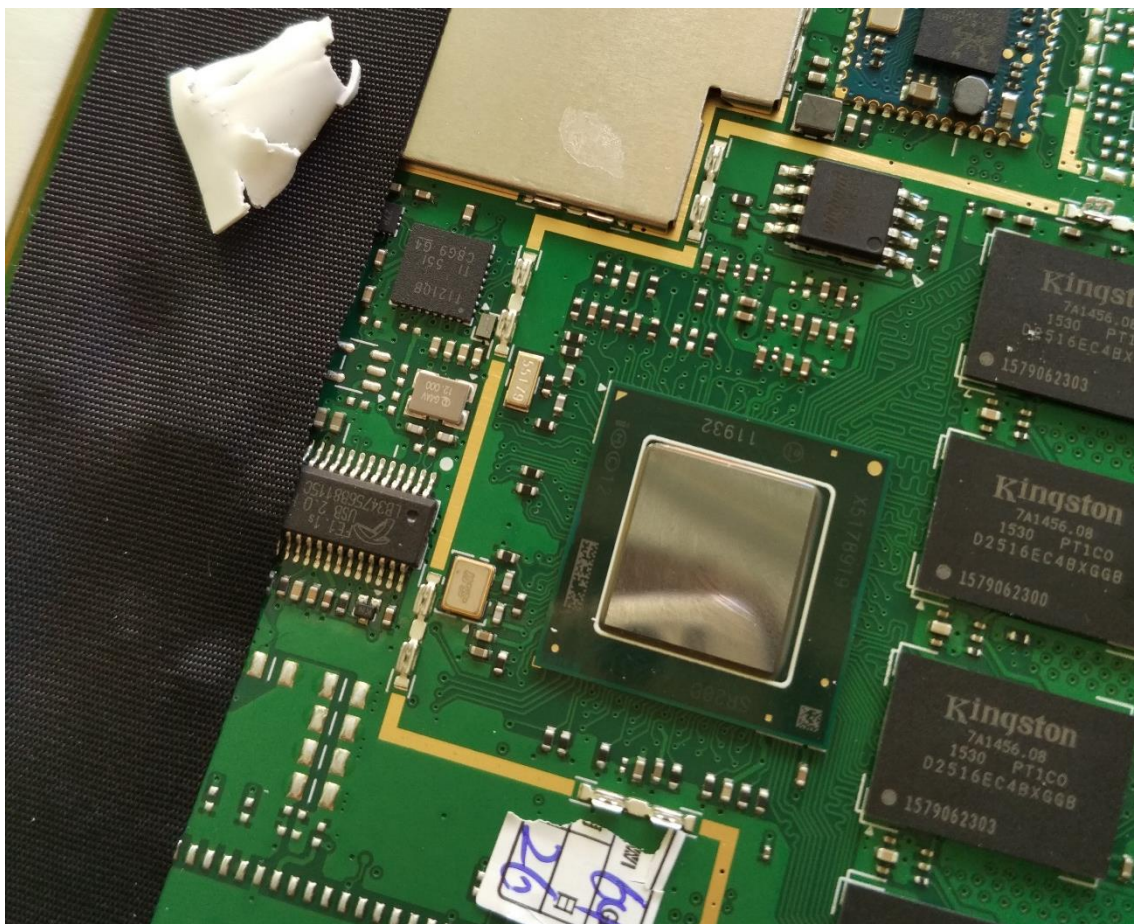


Ilustración 3

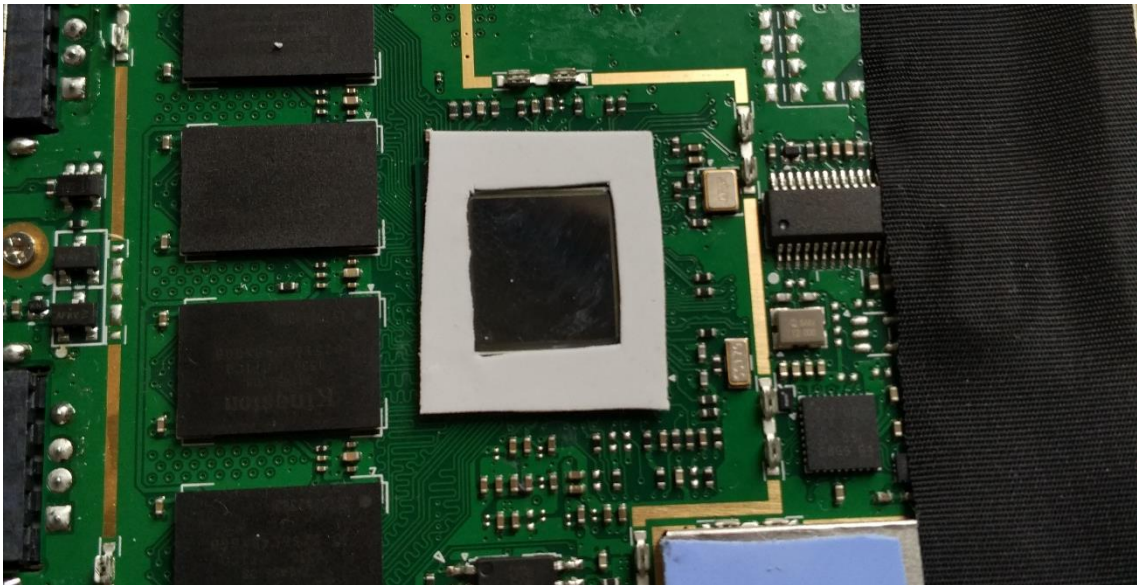
2. El siguiente paso es retirar la chapa metálica y estaremos en el procesador y los módulos de la memoria ram.



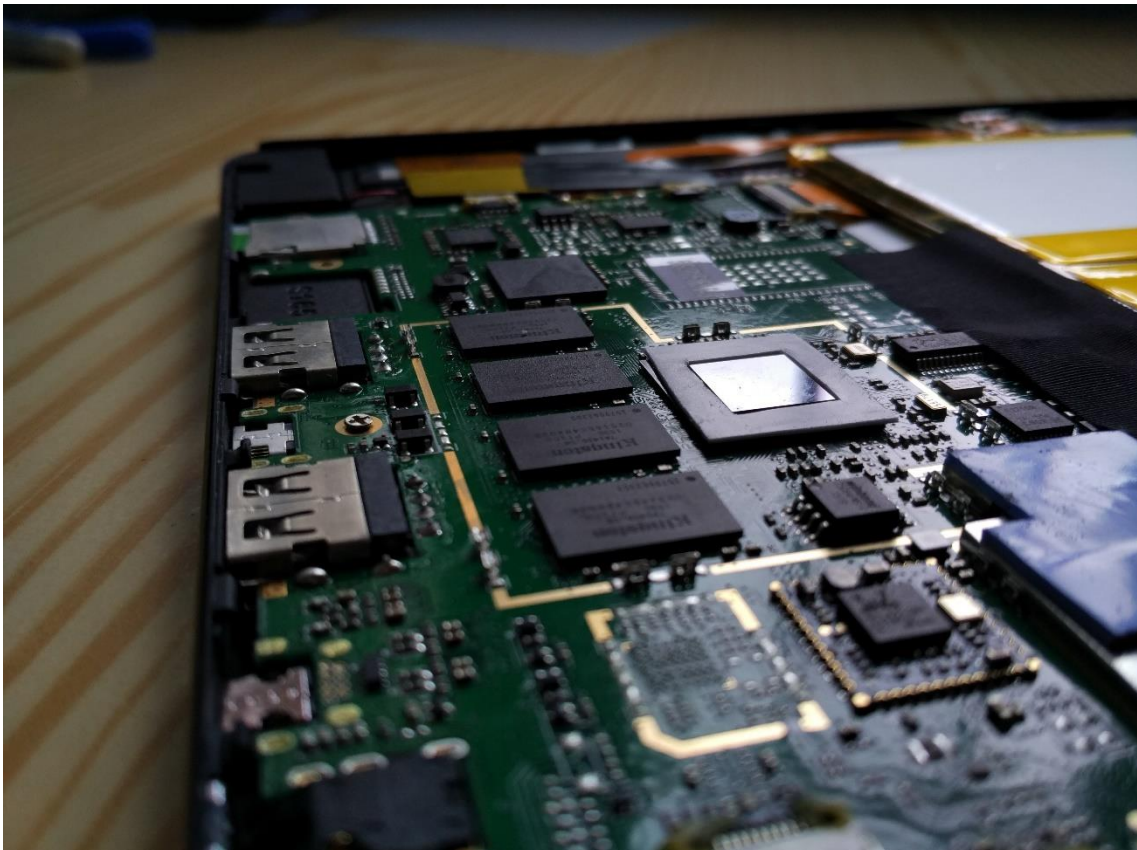
Una vez en este punto quitamos la thermal pad que hay encima del procesador.

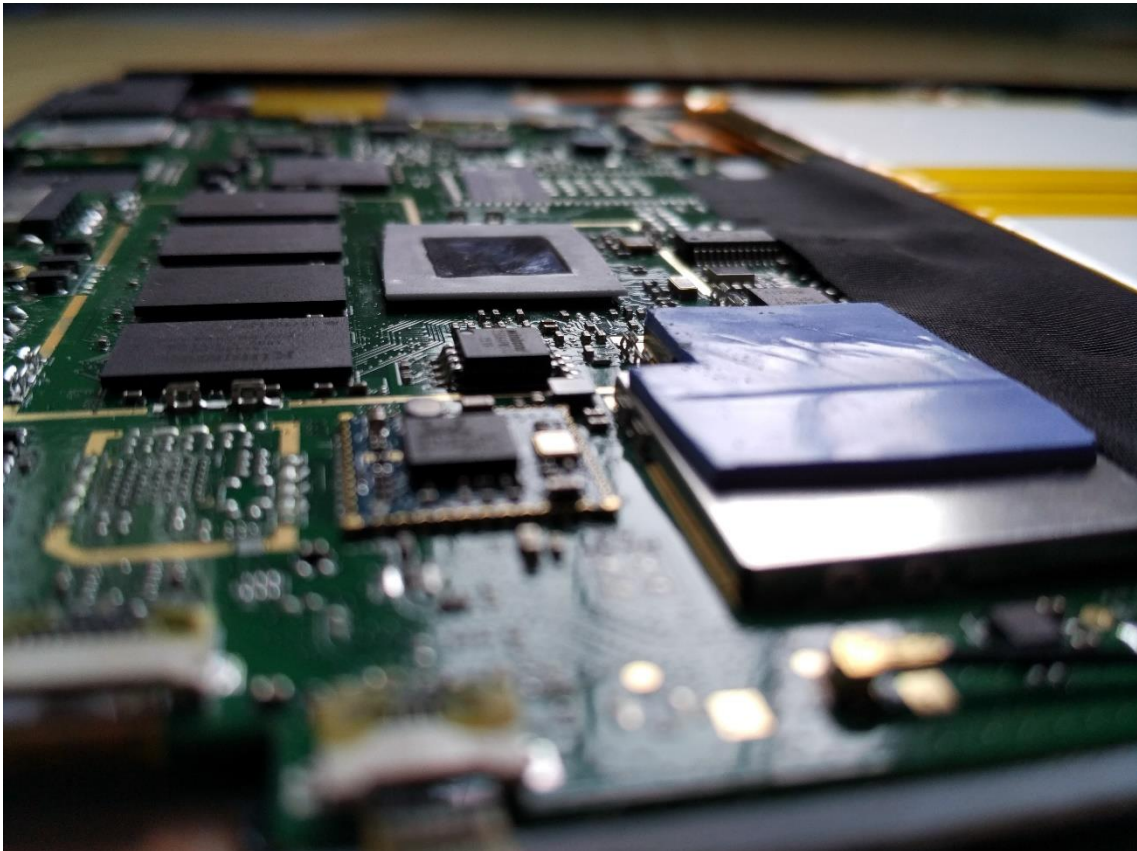


3. Se debe limpiar la zona metálica con mucho cuidado con un poco de alcohol y con algodón suavemente.

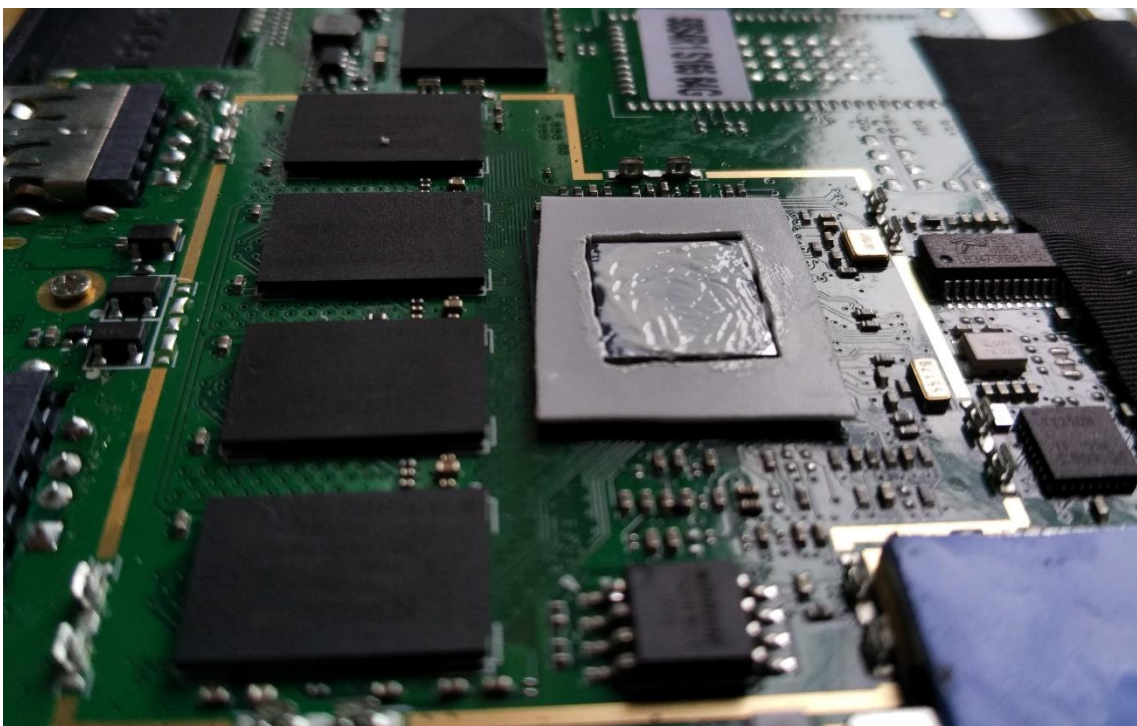


Cogemos la thermal pads y la ponemos encima del procesador y con la ayuda de un cúter dejamos al descubierto la parte metálica del procesador. Lo importante es que no supere la altura de la parte plana del procesador ya que ahora debe hacer un buen contacto la chapa de cobre.





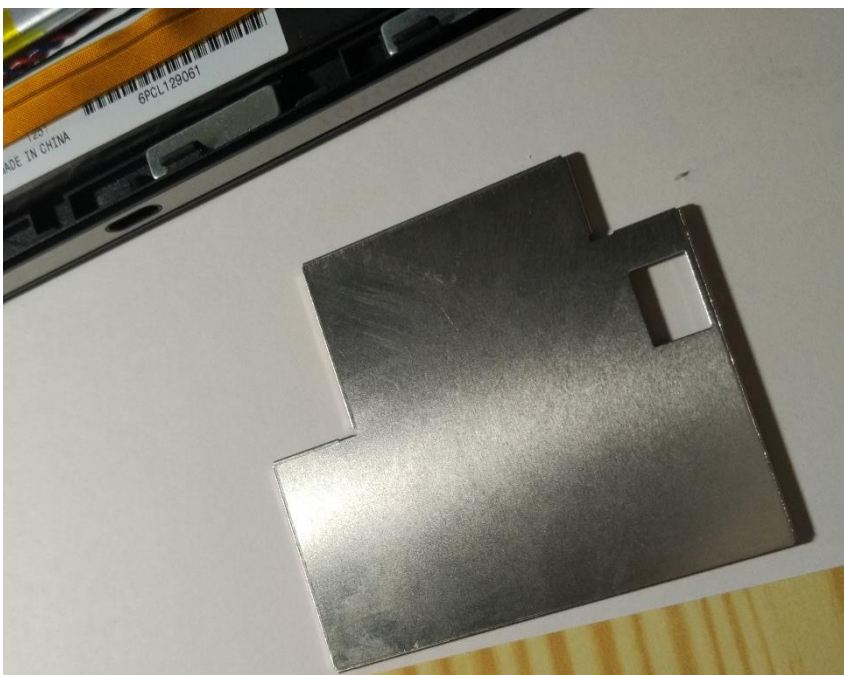
4. Ahora es el momento de coger la pasta térmica, recomendando alguna de marca ya que con pastas de poca calidad se notan algunos grados de más. En mi caso usé (Artic Silver Ceramique 2). El proceso es bastante sencillo, se debe colocar una pequeña cantidad de pasta en el centro del procesador y nos encargamos de extenderlo con las manos de forma que quede expandido por toda la zona, debe ser una fina capa.



5. Ahora con cuidado colocar la chapa de cobre encima y ejercer un poco de presión. Tener especial cuidado en que la chapa no se mueva.



- Llegados a este punto, lo que voy a detallar a continuación es opcional, pero he notado mejores resultados en cuanto a disipación. Consiste en coger la chapa que cubre al procesador y las ram y hacerle algunos boquetes en los laterales como se muestra en la figura 4, para que el foco de calor tenga alguna salida de aire en este caso caliente. No se pueden efectuar muchos boquetes ya que perdemos la consistencia de la chapa y nos será muy útil para conectar la chapa de cobre con esta chapa para seguir sacando el calor hacia capas exteriores.



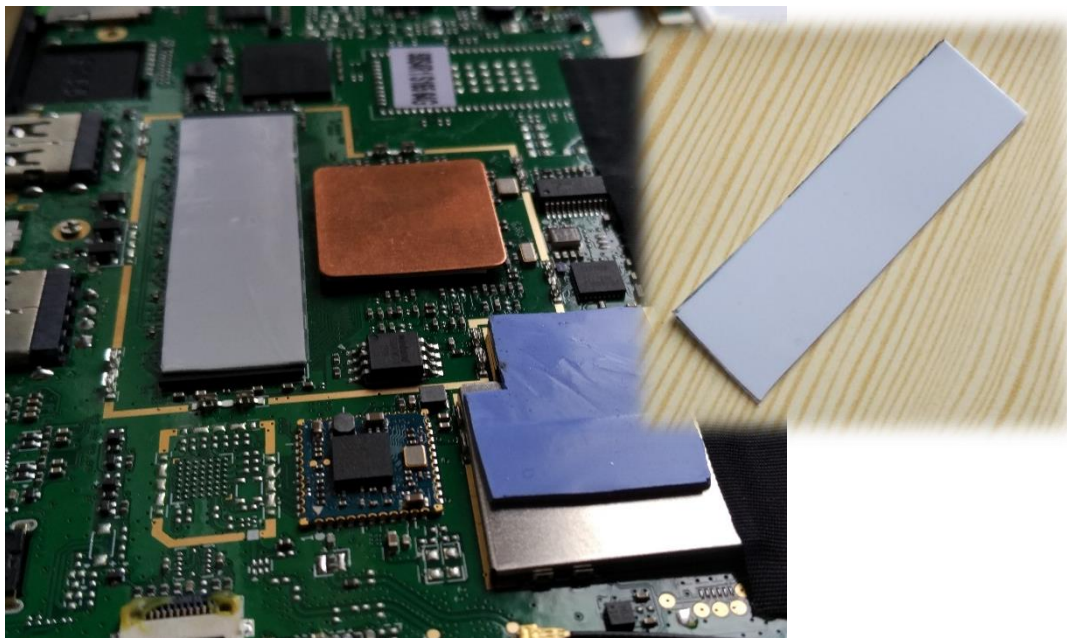
Los boquetes se han realizado con una broca de 0,1 con la multiusos dremel, teniendo mucho cuidado y con un soporte para hacer agujeros. Hay que tener cuidado en este aspecto y por eso lo dejo como opcional para aquellos más expertos y con manejo de herramientas.



Con agujeros queda de la siguiente forma en la que se han apreciado mejoras ya que se han realizado varias formas de disipar y expongo la que mejor resultados ha dado.

Ilustración 4

6. Para cubrir las rams, se corta una tira recta de termal pads para colocarla encima de todas las rams y evacuar el posible calentamiento que puedan generar.



En el chip cercano que es la memoria también se le coloca un trozo de termal pad.

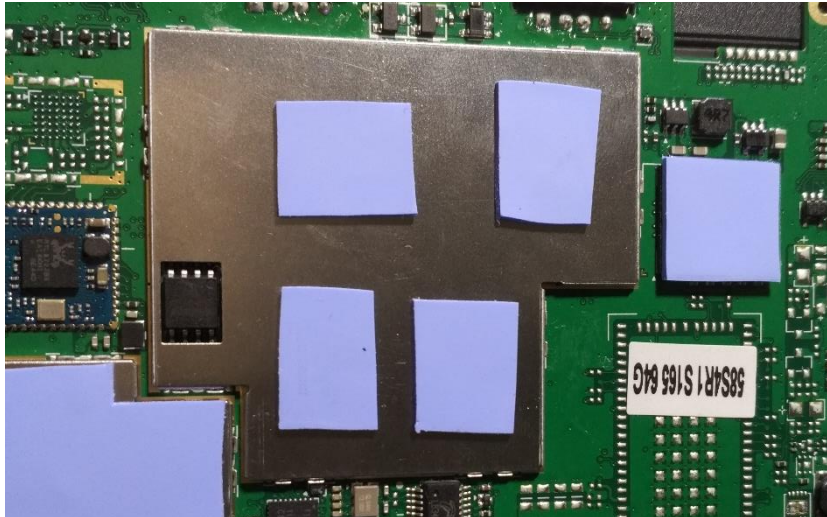


7. Para hacer que la chapa que va encima se lleve gran parte del calor generado en la zona se debe hacer un buen contacto entre la chapa de cobre y la chapa metálica, para ello se vuelve a poner pasta térmica sobre la superficie de la chapa de cobre y la extendemos. Hay que tener cuidado a la hora de extender la pasta, ya que es un poco dura y puede provocar que se mueva la chapa de cobre, coger la chapa por los bordes con una mano y con la otra extender.



Lo siguiente es colocar la chapa metálica encima y cubrir con ello todo. Hay que prestar atención a poner los enclaves de la chapa metálica a la primera, ya que si la colocamos mal y hay que rectificar levantándola de nuevo, es posible que la chapa de cobre se quede pegada a la chapa metálica con ello deberíamos repetir los pasos (3-4-5).

8. Una vez se coloque la chapa metálica (adjunto foto sin los agujeros) es hora de poner un thermal pad encima.



9. Por ultimo solo hay que colocar la tapa trasera de la Tablet, es sencillo es solo presionar en los clics hasta que encajen todos.

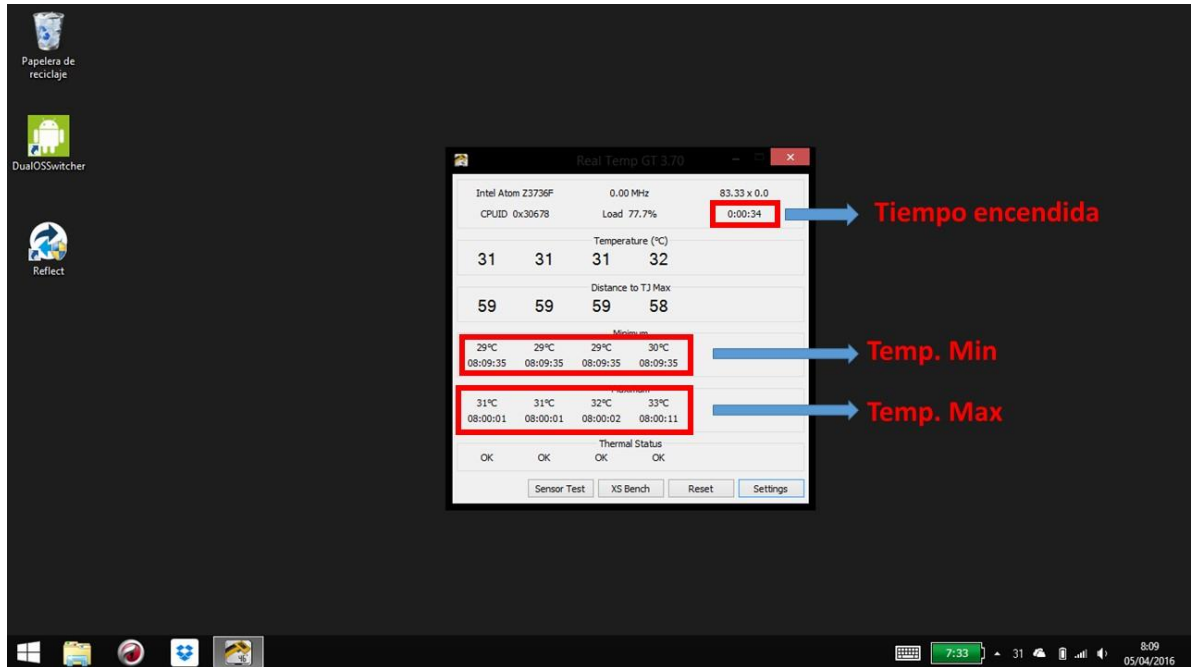
Y esto es todo, ahora la prueba definitiva es comprobar si se ha conseguido bajar unos grados la temperatura del procesador que es lo que se busca en todo momento.

- ❖ **Asegurarse en todo momento de no haberse dejado nada atrás y de haber seguido todos los pasos.**

Comprobación de temperaturas

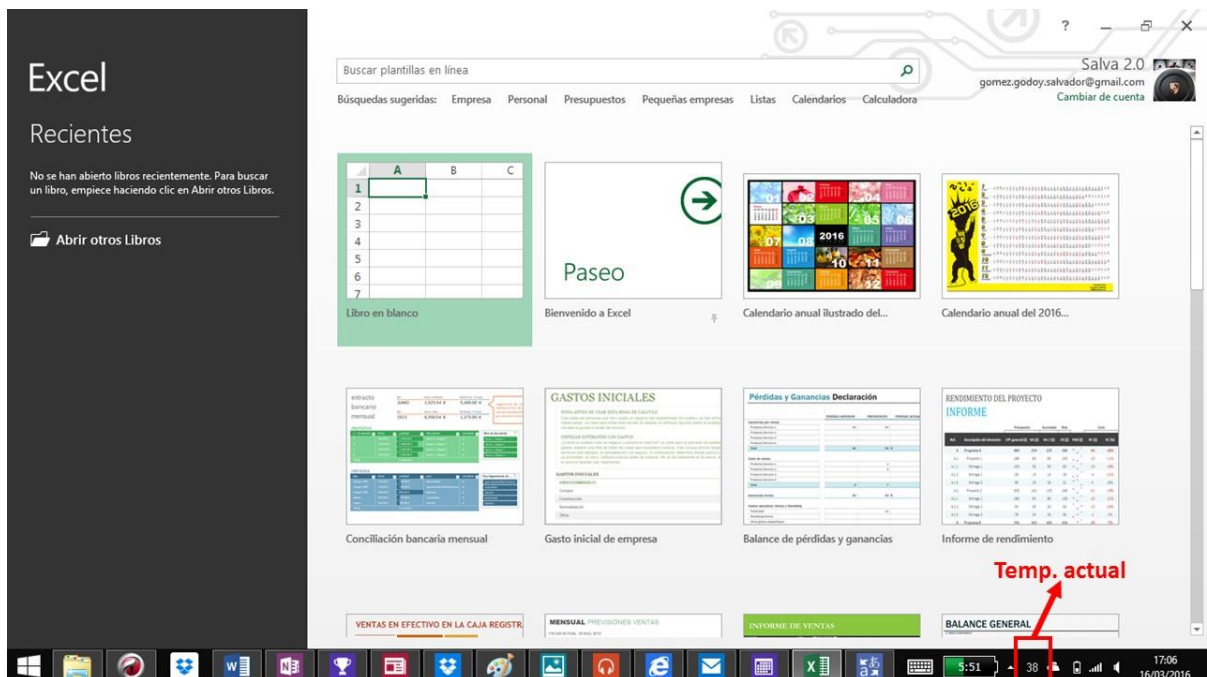
La temperatura a la que se sometía la Tablet de normal eran unos 40° - 45° al menos en mi caso, de ahí el querer bajar la temperatura.

- Para las pruebas adjunto captura de temperatura nada más encender:

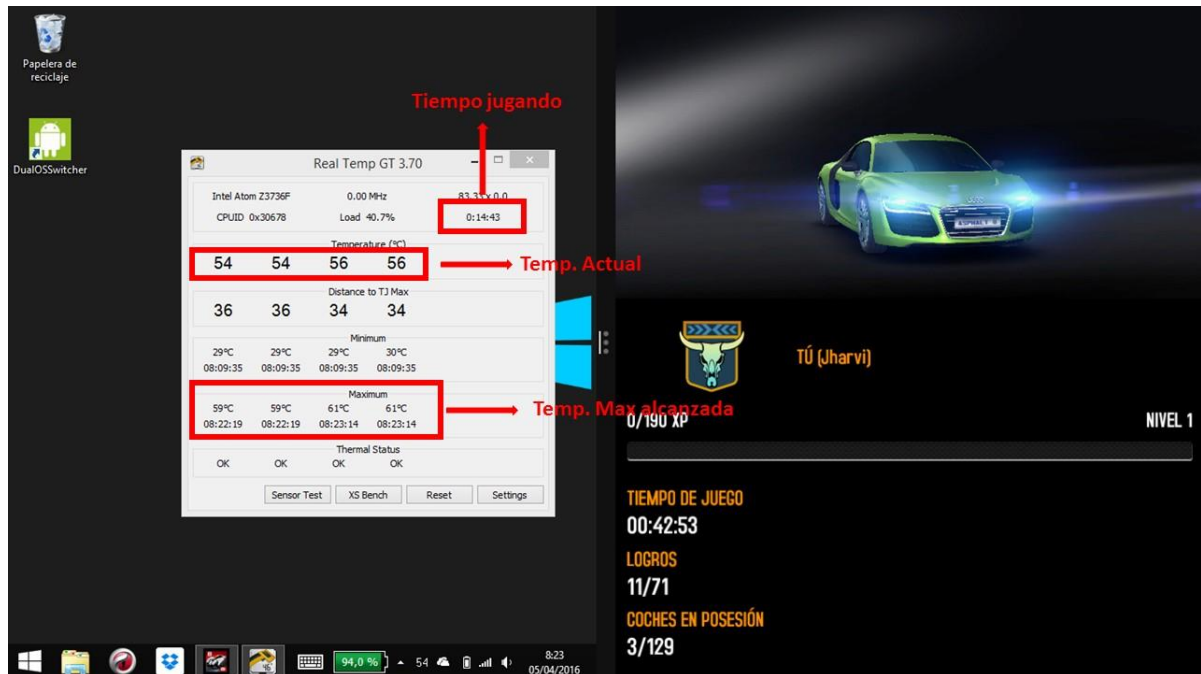


Se puede ver que al iniciar ha tenido un mínimo de 29° con un máximo de 33°.

- Otra de las pruebas es apretando un poco la Tablet con muchos programas abiertos y algunos de cierta exigencia.



- La última prueba y la más exigente ha sido jugando al juego de la tienda Windows (asphalt airborne 8). Ha sido un tiempo de 15 min y ha dado de máximo 61°.



Conclusión

Con respecto a la mejora de temperatura efectuado es más que satisfactorio, se puede apreciar como bajan las temperaturas incluso cuando se le exige rendimiento al procesador. No es una mejora que suponga gran coste de precio, solo un poco de paciencia al estar tratando con elementos de cuidado, por lo demás es muy asequible y ayudará a mantener la vida útil de los componentes por más tiempo.